

## **Bericht zur Veranstaltung „Die deutsche Elektronikindustrie in der Krise: Gemeinsamer Workshop um Lösungen zu finden“ der Regionalgruppe Stuttgart am 01.04.2009 bei der riese electronic gmbh in Horb am Neckar**

Am 01.04.2009 fand der Workshop der Regionalgruppe Stuttgart unter der Leitung des Regionalgruppenleiters Oliver Riese, statt. Empfangen wurden die mehr als 30 Teilnehmer in den Räumlichkeiten der riese electronic gmbh in Horb am Neckar.

Nach dem Come-Together bei kleinem Imbiss wurden die Teilnehmer vom Gastgeber begrüßt. Eberhard Renz, Vertriebsleiter der riese electronic gmbh, stellte das gastgebende Unternehmen vor. Im Anschluss daran empfing der Regionalgruppenleiter der FED-Regionalgruppe Stuttgart und Geschäftsführer der riese electronic gmbh, Oliver Riese, die teilnehmenden Mitglieder und Interessenten des FED mit einer Kurzvorstellung des Verbands.



Der Workshop wurde eröffnet durch drei Impulsreferate, in denen die Referenten die aktuelle Situation der deutschen Elektronikindustrie aus deren Sicht darstellten. Herr Peter Jegart, Vertriebsdirektor Mitte des Distributors Spoerle, Herr Reiner Wieland vom Ingenieurbüro Wieland PCB Ltd und Stellvertretender Regionalgruppenleiter sowie Herr Oliver Riese legten ihre Sicht der Dinge dar.



Der eigentliche Workshop startete dann unter der Leitung des Projektberaters Herrn Holger Zimmermann. In Gruppenarbeit und aktiver Diskussion wurden Lösungen zur Krisenbewältigung erarbeitet.

Es wurde von den Besuchern vereinbart, dass die interessanten Maßnahmen und Ergebnisse nicht im Detail veröffentlicht werden, da die Vertreter der teilnehmenden Firmen viele sensible Firmendaten in die Diskussion mit eingebracht haben. Ein Fotoprotokoll aller erarbeiteten

Lösungen und Maßnahmen wurden den Teilnehmern am Ende der Veranstaltung ausgehändigt. Die Schlussdiskussion der rundum gelungenen Veranstaltung wurde bei schwäbischer Maultaschensuppe bis zu 2 Stunden nach Veranstaltungsende geführt.

Die nächste Veranstaltung der Regionalgruppe Stuttgart findet am 09.07.09 zum Thema „Eigenschaften von Basismaterialien“ und „Bleifrei HAL-Oberfläche – Schnittstelle zur Bestückung“ statt.

Der Ort der Veranstaltung wird in Kürze bekannt gegeben.

*Oliver Riese, Leiter der Regionalgruppe Stuttgart*